

磨き上げた表面処理薬品と技術

奥野製薬工業は研究開発型企業として先端産業の要望に応え、表面処理・無機材料・食品分野で培った技術とノウハウを生かして、豊かでクリーンな未来づくりに貢献する。半導体関連を重点事業と位置付け、2030年度に売上高420億円を目標に掲げる。中核は半導体ウエハー向け表面処理「TORYZA A（トライザ）」シリーズ。企業ロゴの「TOP（トップ）」に、産業の米と呼ばれる半導体分野への貢献を込め、ラテン語で「米」を意味する「ORYZA（オリザ）」を組み合わせて名付けた。TORYZA EL PRO CESS / SYSTEM は、ウエハ上アルミニウム電極向けのUBM形成用無電解めっきプロセスと専用めっき装置である。アルミニウム電極の局部腐食を低

半導体ウエハー向け拡充



TORYZA EL SYSTEM

減し、400度の熱処理でもクラックが発生せず、高温常用に対応可能な無電解ニッケルめっき皮膜が得られる。TORYZA LCNシリーズは、高アスペクト比ビアフィリング（LCN SV）や高電流密度での銅ヒラー形成（LCN SP）に対応した半導体ウ

エハー用硫酸銅めっき添加剤である。TORYZA LCN LXDは、200度付近の低温でダイレクト接合を可能にするCuCuハイブリッドボンディング用硫酸銅めっき添加剤であり、CMOSやNANDなどの三次元積層デバイスへ提案する。